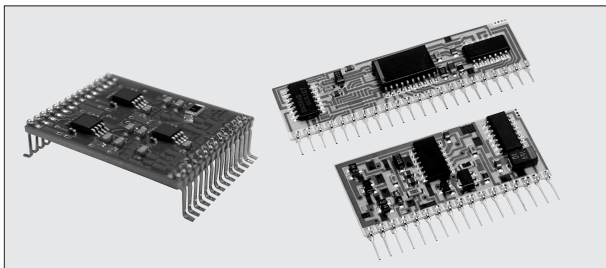


KA ■ カスタムハイブリッドIC



■特長

- ファンクショントリミング、レシオトリミングにより調整工数を低減。
- ボンディングによる高密度実装(COB)。
- 各種パッケージに対応可能。
- KOAの厚膜技術により信頼性の向上。

■RoHS対応

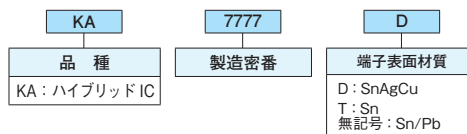
- 厚膜印刷基板、プリント基板共に各構成部材の最適化を行い内部接続はんだの鉛フリー化を実現しました。

■用途

- 自動車機器 (ECU、パワーウィンド)
- 電源機器 (DC/DCコンバーター・AC/DCコンバーター、安定化回路・リチウムイオンバッテリー充放電回路)
- 産業機器 (各種コントロール回路)
- 通信機器 (電話交換機、LAN・トランシーバー、VCO・VTXO)

■品名構成

例



■構成部品

KA Series				
	項目	印刷	実装	ボンディング
基板材料	Al ₂ O ₃ アルミナ	○	○	○
	ガラエポ	×	○	○
導体・抵抗	項目	Ag-Pd	Ag-Pt	
	導体抵抗	18mΩ/□/15μm	5mΩ/□/10μm	
	熱衝撃	-55°C~+125°C 300 Cycles	-55°C~+125°C 500 Cycles	
	抵抗体	5Ω~10MΩ ±100×10 ⁻⁶ /K		
実装	項目	仕様		
	COB	Au Wire, Al Wire		
	BGA	0.5mm Pitch~		
	QFP	0.4mm Pitch~		
	Chip	0.4mm×0.2mm~		
形状・外部端子	形状	リードピッチ		
	SIP	1.8mm, 2.0mm, 2.5mm, 2.54mm		
	DIP, SOP	1.27mm, 1.8mm, 2.54mm		
	ZIP	2.54mm		
	BGA, LGA	1.0mm~		
外装・表面処理	外装	色		UL規格
	エポキシ系変成フェノール	黒		94 V-0認定品
	エポキシ	黒		94 V-1認定品

厚膜回路基板での出荷対応も致します。

ハイブリッドIC